

◇◇◇ NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)定期講演会 ◇◇◇
◇◇◇ ◇◇◇
◇◇◇ 第29回 ◇◇◇
◇◇◇◇ ◇◇◇◇

がんばれニッポン PartIV

～AIを支える半導体は～

主催：NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)

協賛：(一社)日本電子回路工業会(JPCA)

協賛：(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)

皆さま お元気ですか。本年も温暖化の影響が続くと思われまますので気をつけましょう。

NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET: 理事長梶田栄)では(一社)日本電子回路工業会(JPCA)、(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)、(一社)エポキシ樹脂技術協会、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC) の協賛を得て(予定)第 29 回定期講演会を今回も Web にて開催します。

今回は「**がんばれニッポン！ PARTIV**」

～AIを支える半導体は～

と題して、各種技術を集めます。奮って参加願います。

* 開催日時：**令和 8 年 8 月 28 日(金)** 13:00～17:25

* 形態 開催方式：WEB開催 (ZOOM使用)

- ・聴講については、原則開催日の前日までに参加URLとパスワードをご連絡します。
- ・講演の録画、録音、撮影は禁止します。
- ・同業他社の方の参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

* テーマ：「**がんばれニッポン！ PARTIV**」

～AIを支える半導体は～

* プログラム：

◆基調講演◆

13:00～13:45「**AI が求める半導体/半導体パッケージ**」

西田秀行氏(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

◆技術講演◆

13:45～14:45「**GPU、TPU だけが AI チップじゃない～推論、エージェント AI、フィジカル AI へと半導体も拡大**」

津田建二氏(国際技術ジャーナリスト)

◆技術講演◆

14:45～15:30「**フィジカル AI としてのモビリティと機器・実装の動向**」

三宅敏広氏(車載エレクトロニクス実装研究所)

(休憩)

◆技術講演◆

15:40～16:25「**未来を創る最先端半導体パッケージング技術**」

荒木 康氏(新光電気工業株式会社)

◆特別講演◆

16:25～17:25「Chiplet はどう生まれ、今後どう進むか？」

宮代 文夫氏 (YJC)

- * 定員 150 名(先着申込順定員になり次第締切ります)
- * 講演会参加費(テキスト代、消費税込み)
C-NET 会員:5000 円 JPCA 会員:5000 円 JIEP 会員:5000 円 非会員:10000 円
C-NET 特別会員:無料

*** 参加費は 8 月 25 日までに請求書記載の銀行口座へお振込ください。**

* 申込先 C-NET 定期講演会

* 次の URL よりお申し込みください。

URL <https://jisso.jp/reg/cnet29/>

申込されずと返信メールで請求書へのリンクが発行されます。

請求書に従って、銀行振り込みにて参加費のお支払いをお願い致します。

* メールアドレス入力ミスで、返信(受付完了)メールが不達になることが頻発しています。
メールアドレスを入力後の再確認をお願い致します。